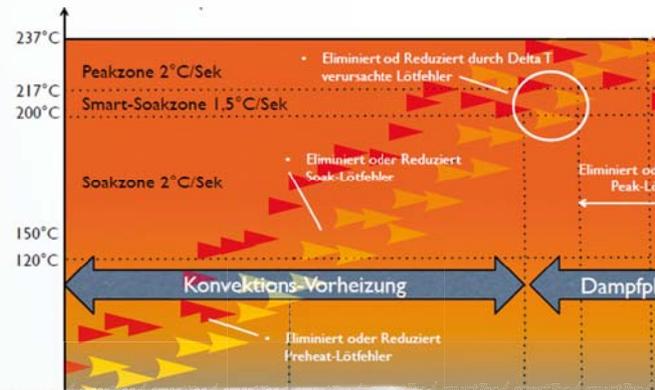


Die intelligente Reflow-Lösung: Dampfphase mit Konvektions-Vorheizung

R & D Dampfphasen-Lötsysteme

Die Konvektionsvorheizung ist die optimale Lösung zur Reduktion von Rückständen und Voiding. In der smartSoak-Zone wird ein optimales Delta T erreicht und dem Tombstone-Effekt entgegengewirkt. In der Peak-Zone wird ein Überheizen der Bauteile vermieden. Ein wesentlich reduzierteres Verweilen im flüssigen Bereich (TAL), wirkt sich positiv auf die Lötqualität und die Taktzeit aus. Somit reduziert oder eliminiert das „Advanced Vapor Profile“ (AVP) die meisten thermisch bedingten Lötfehler.



- Einzigartige Kombination aus Konvektions-Vorheizung und Dampfphase
- Sehr gut geeignet für Baugruppen mit großer thermischer Masse
- Ideal für Baugruppen mit großem Bauteilmix (heterogene Wärmeaufnahme)
- Ermöglicht ausgezeichnete Regelung der Temperaturgradienten
- Reduktion von Voiding und Tombstoning durch „freies Ausgasen“
- Optimales Delta T durch Verweilen in der smartSoak-Zone
- Kein Überheizen von Bauteilen oder Laminaten in der Peakzone
- Optimale Verweildauer in der „flüssigen Phase“ (Time above Liquid)
- Batch- oder Inlinesystem für Leiterplatten bis zu 607 x 607mm

Beschreibung

Dampfphasenlötens liegt voll im Trend. Der Bauteilmix mit einerseits sehr kleinen Komponenten, andererseits aber hochintegrierten massereichen Bauteilen, der JEDEC Standard J-STD 020 D für feuchtigkeitsempfindliche Bauteile, die steigende Verarbeitung von LED's - all dies stellt erhöhte Anforderungen an das Bleifrei-Profil.

Die Firma R&D besticht mit einem durchdachten, runden Dampfphasen-Reflowkonzept, welches genau für diese Marktentwicklung konzipiert wurde. Jeder Kunde findet hier die optimale Lösung für sein Lötproblem. Neben kompakten, kostengünstigen Lösungen, bei welchen das

komplette Profil in der Dampfphase mit sehr feiner Steuerung gefahren bietet smartTec die Kombination mit einer Konvektionsvorheizung, welche die Vorteile der Konvektion und die Vorteile der Dampfphase in einem System vereint (*Advanced Vapour Profile, AVP*).

Vom Table Top System über Batch-Anlagen bis hin zur innovativen Inline-Dampfphase bietet Advanced Vapour Profile die perfekte Lösung für jeden Reflowaufgabe. Selbst Leiterplatten bis zu 607 x 607 mm stellen kein Problem dar.

°
°

Vorteile des Dampfphasen-Lötens mit Advanced Vapour Profile:

- Lötgarantie
- ° - Kein Überhitzen
- ° - Vermeidung von Oxidation
- ° - Sehr feine Profilierung
- ° - Easy to Use
- ° - Geringe Betriebskosten
- ° - Reduziert Voiding
- ° - Reduziert Rückstände
- ° - Reduziert Temperaturstress

Wichtige Fakten auf einen Blick (Advanced Vapour Profile)*

Anlagentyp	RD1 (Batch)	RD 2 (Batch)	RD 3 (Batch)	RD 52 (Inline)
LP-Abmessungen max., mm (L x B)	250 x 300	455 x 380	607 x 607	450 x 380
Lichte Höhe Produkt, mm	55	63	127	???
Maschinenabmessungen, cm (L x B x H)	180 x 84 x 122	241 x 100 x 137	365 x 137 x 120	411 x 116 x 116
Vorheizung	4 Zonen individuell regelbar			
Stromversorgung Standard, VAC	208, 3 Ph.	208, 3 Ph.	480 3 Ph.	480 3 Ph.
Stromversorgung ohne Last, VAC	380, 3 Ph., 1 neutr.	380, 3 Ph., 1 neutr.	400, 3 Ph., 1 neutr.	400, 3 Ph.
Stromstärke, Amp., Hz	40, 50/60	63, 50/60	80, 50/60	80, 50/60
Leistungsaufnahme Hauptheizung, kW	7,5	12,5	26	???
Leistungsaufnahme Vorheizung, kW	3	6	11	???
Arbeitstemperatur, °C (abhängig von verw. Flüssigkeit)	200 - 320	200 - 320	200 - 320	200 - 320
Wasserbedarf (l/min. bei 25 °C - 40 °C)	11 - 15	11 - 19	15 - 23	11 - 19
Inerte Flüssigkeit, Kapazität in l.	7,5	11,5	19	11,5



* Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte ausführliches Datenblatt an